

# 导热硅胶薄材 /XK- R15

## 简介:

XK-R 系列为无基材硅胶导热薄材, 比传统玻纤布更好的导热与填缝能力,导热系数 1~4.8W/mk, 比传统硅胶片更薄的界面厚度(BLT), 适合 0.2~0.5mm 范围的价格竞争的应用

## 特性:

超薄厚度( 0.2~0.5mm )

无基材设计

适当的压缩性

高性价比

## 应用:

消费性电子产品

自动化设备、军规设备、医疗设备



	unit	XK-R15	Method
Thickness	mm	0.2~10	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm <sup>3</sup>	2.5	ASTM D792
Hardness	Shore A	20	ASTM D2240
Thermal Conductivity	W/mK	1.5	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	15	ASTM D149
Dielectric Constant	1	6.5	ASTM D150
Application temperature	°C	-50~200	
Tensile strength	psi	100	ASTM D149
Elongation	%	100	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94